

导热凝胶 Thermal Gel

【产品概述 Product Description】

SE300AB 是一种柔软的双组份硅树脂基导热缝隙填充材料，具有高导热率、低界面热阻及填充性，是小缝隙公差场合应用的理想材料。它填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触、减小热阻，快速有效地降低电子元件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。SE300AB 可通过手工方式或点胶设备进行涂装，固化后为弹性体，可以保护元器件。

【产品图示 Product Illustration】



【产品用途 Product Usage】

- 硬盘、手机
- 光学精密设备
- 笔记本电脑
- 移动及通讯设备
- 汽车发动机控制设备
- 高端工控及医疗电子等领域

【特点优势 Characteristic advantage】

- 高导热，低热阻，极好的润湿性
- 对电子元器件更低组装应力
- 易于管理的原材料库存，更低综合成本
- 可填充任何高低不平的间隙
- 高可靠性，固化后的导热胶等同于导热硅胶垫片，无挥发
- 不同于粘接胶，其粘接力较弱，不能固定散热装置

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输

【包装】 A/B 胶管 :50ml；A/B 胶管:400ml；A/B 桶装:20KG。

【有效期】 本产品有效期为 6 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS) 》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。

特性参数 SE300AB			
产品性能	测试结果		测试标准
混合前	A 组分	B 组分	
颜色	白色	粉色	目视
粘度 (cps)	600000	600000	ASTM D2196
混合比例	1:1		***
表干 (min)	20±5 (25°C)		***
固化时间	20min (100°C)		***
	5±1h (25°C)		***
体积电阻率 (Ω·cm)	1.0*10 ¹³		ASTM D257
导热系数 (W/m.K)	3.0		ASTM D5470
击穿电压 (KV/mm)	≥6.0		ASTM D149
介电常数 (@1MHz)	7.0		ASTM D150
密度 (g/cm ³)	3.0		ASTM D792
使用温度	-40~150°C		***
热失重/%	≤0.1		@150°C 48H
阻燃等级	V-0		UL 94
硬度 (Shore 00)	45±5°		ASTM D2240
RoHS	PASS		IEC 62321
Halogen	PASS		EN14582
REACH	PASS		EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

注：颜色/硬度均可按客户需求调试。